

HITACHI

日立ハイテク

株主通信

平成18年度(第88期)中間期
(平成18年4月1日から9月30日まで)

日立ハイテク発足5周年

ハイテク・ソリューション事業における グローバルトップを目指します

日立ハイテクノロジーズは、あらゆるステークホルダーから「信頼」される企業を目指し、ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じ、社会の進歩発展に貢献します。あわせて、当社は「公正かつ透明」で信頼される経営を行い、成長し続けていくとともに、「環境との調和」を大切にし、情熱と誇りを持ち、社会的責任を全うする企業市民として豊かな社会の実現に尽力します。

株主の皆様へ	1	連結損益計算書、 連結キャッシュ・フロー計算書	11
日立ハイテク発足5周年		個別貸借対照表	12
社長インタビュー	2	個別損益計算書、配当の状況	13
日立ハイテク5年間の歩み	4	ネットワーク	14
平成18年度中間期		会社の概要	15
事業概況	6	株式の状況	16
トピックス	8	株主メモ	17
財務ハイライト(連結)	9		
連結貸借対照表	10		

株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃のご支援とご理解に深く感謝するとともに、平成18年度(第88期)中間期(平成18年4月～9月)の概況をご報告申し上げます。

当社は、先端技術開発力と商社機能を併せ持つ当社グループならではの事業活動を通じ、「ハイテク・ソリューション事業において、グローバルトップを目指す」という企業ビジョンの実現を図るべく、積極的に事業を展開しております。

当中間期における業績は、売上、利益ともに前中間期を上回り、特に利益面では中間期としては過去最高益を達成しました。これは、電子デバイスシステム事業、ライフサイエンス事業を中心に業績が好調に推移したことに加え、グローバルな視点で最適なオペレーションの構築を目指して進めている事業再編などの施策が収益の向上に結びついた結果と考えています。配当金につきましては、これら好調な業績に鑑み、株主の皆様に適正な利益の還元を行うべく、1株当たりの中間配当金を当初計画の10円00銭から12円50銭に増配することといたしました。

当社グループは、価格競争の激化や原油・資材価格の高騰など厳しい経営環境の中でも継続的に高収益を確保できる収益基盤の構築に向け、今後とも顧客第一主義の徹底、新規事業・グローバル事業の積極推進を図るとともに、連結経営の強化と経営革新の推進に取り組んでいく所存です。同時に、企業の社会的責任をこれまで以上に強く意識した経営を行い、ステークホルダーの皆様からの信頼の獲得と、事業活動を通じた社会の進歩、発展への寄与に努めてまいります。今後とも、変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

平成18年11月

取締役会長 代表執行役

桑田 芳郎



取締役会長 桑田 芳郎



執行役社長 林 將章

日立ハイテク発足5周年

PRESIDENT INTERVIEW 林将章社長インタビュー

QUESTION 1

「日立ハイテクノロジーズ」の誕生から5年が経過しましたが、その間の経営環境の変化と対応についてお聞かせください。

当社は平成13年10月、日立製作所の計測器グループ、半導体製造装置グループとの事業統合に伴い、社名を「株式会社日立ハイテクノロジーズ」に変更し、第2のスタートを切りました。

初年度となつた平成13年度は、IT不況で前年度比大幅な減収減益となつたため、当社は商社機能と開発製造機能の有機的融合による競争力強化に注力しました。続く平成14年度は世界同時不況とデフレスパイアルが進み、引き続き厳しい事業環境の中、基盤事業の強化とアプリケーション事業の対応強化に努めました。

平成15年度は米国経済が回復、中国市場も台頭する一方で国内景気も底を打ち、事業環境の明るさが増す中で、当社はグローバル化の推進、新事業の創出、ガバナンス強化に取り組みました。平成16年度は米国経済の好調な推移、設備投資意欲の回復、デジタル家電の需要拡大に対し、半導体製造装置事業の強化、液晶・ハードディスクドライブ関連製造装置事業の譲受などを行いました。平成17年度は世界的に景気が回復基調となり、中国市場も拡大する中、海外事業の強化、事業拠点・グループ会社再編を進めました。

QUESTION 2

これまで取り組まれた施策に対する評価と、今後の課題をどのように考えていますか。

5年間で事業環境は大きく変化しましたが、その都度適切な施策を講じ、実行してきました。商社機能と開発製造機能のシナジー発揮には特に注力しており、これは営業部門の最前線の情報がR&D、製造部門へ迅速にフィードバックされるなど、着実に成果が現れています。

今後の課題は、開発力のさらなる強化、製品競争力の向上、新事業への積極的な取組み、エマージング市場を含む海外事業の強化と考えています。

QUESTION 3

業績の推移をご覧になっていかがですか。

液晶・ハードディスクドライブ関連製造装置の事業を新たに当社グループに取り込んできましたので、売上規模は順調に拡大してきました。しかし重要なのは市場の伸びを上回る成長力と収益性を兼ね備えることですから、市場動向や顧客のニーズを的確にとらえ、競争力の高い製品をタイミングで市場投入することが不可欠と考えています。そこで営業力、開発力強化のために経営資源を重点的に投下していきます。

日立ハイテク発足5周年

執行役社長 林 將章



商事部門においては商社機能を発揮した調達・販売により、最先端ソリューションの提供で売上拡大に貢献してきました。今後は付加価値提供型ビジネスの推進やエマージング市場を含めた、さらなるグローバル展開などにより、売上高の拡大と収益力の向上を追求していきます。

こうして製造機能と商社機能のシナジーを追求することにより、当面は連結売上高1兆円、営業利益500億円とすることを目標としています。

QUESTION 4

平成18年度についてはどのように見込んでいますか。

当中間期の半導体製造装置、液晶関連製造装置に関しては、顧客の設備投資動向などから、厳しい見通しを立てていましたが、実際に

は、半導体メモリーメーカーの強気の投資姿勢や液晶パネルメーカーの新型露光装置やモジュール組立装置への投資意欲が堅調だったことなどにより、計画を上回る業績を挙げることができました。また、ハードディスクドライブ関連製造装置もハードディスクの需要拡大に伴ってメーカーの設備投資が増強されたことに加え、医用分析装置も販売強化と新製品投入効果により予想を大きく上回る業績となりました。また、商事部門においては原油や材料価格の高騰が追い風となり、当中間期も好調を維持しました。

下期については、半導体製造装置では設備投資動向の不透明感、液晶関連製造装置では韓国・台湾大手パネルメーカーの計画延期、ハードディスクドライブ関連製造装置では投資の一巡などが影響する可能性もあり、当社でも市場や顧客動向を注視して取り組みたいと考えています。

CORPORATE HISTORY

日立ハイテク5年間の歩み～日立ハイテクは次なるステージへ～



平成13年10月 (株)日立ハイテクノロジーズ誕生



日製産業(株)と(株)日立製作所の計測器・半導体製造装置グループの統合により「(株)日立ハイテクノロジーズ」としてスタートしました。これにより、従来の商社機能に加えて、半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー事業に関する開発から製造、販売、サービスまでの一貫体制が整いました。

ビスに変更しました。この結果、両社が有するチップマウンタ事業の開発から製造、販売、サービスまでの一貫体制を確立しました。



平成15年6月 委員会等設置会社に移行

平成14年4月の商法改正施行を受け、定時株主総会承認後、委員会等設置会社に移行しました(平成18年5月の会社法施行により委員会設置会社)。業務執行と監督の機能を分離し、経営の意思決定の迅速化、コーポレート・ガバナンスの強化を図りました。



平成15年4月 チップマウンタ事業を譲受け

三洋電機(株)が保有している三洋ハイテクノロジー(株)と三洋ハイテクサービス(株)の全株式を取得し、それぞれ社名を(株)日立ハイクインツルメンツおよび(株)日立ハイテクインツルメンツサー



平成15年12月 企業ビジョンを策定

「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指す」という企業ビジョンを策定しました。当社グループ全体でこの目標の実現に向け、ビジョンに基づいた企業活動を実践してまいります。

沿革

2001

- 平成13年
① 10月 (株)日立ハイテクノロジーズ誕生
(株)日立メディコより検体検査装置の営業を譲受け

2002

- 平成14年
1月 日製産業貿易(深圳)有限公司(現 日立高新技術(深圳)貿易有限公司)設立
3月 ギーゼック・アンド・デブリエント(株)設立
4月 Hitachi High Technologies America, Inc.設立
6月 「連結中期経営計画」を策定

2003

- 平成15年
② 4月 チップマウンタ事業を譲受け
③ 6月 委員会等設置会社に移行
④ 12月 企業ビジョンを策定



平成16年3～4月 半導体製造装置、液晶・ハードディスクドライブ関連製造装置事業を譲受け

半導体関連装置事業の強化を目的として、(株)日立製作所が保有していた日立電子エンジニアリング(株)の全株式を取得するとともに、社名を日立ハイテク電子エンジニアリング(株)と変更しました。半導体検査装置のラインアップ強化とともに液晶関連およびハードディスクドライブ関連製造装置事業の拡大を図ってまいりました。



平成17年4月 那珂事業所の新クリーンルーム棟が稼動



さらなる飛躍を期して、新建屋を建設し、半導体製造装置などの研究開発機能を那珂事業所に集約しました。新建屋は、一階がクリーンルーム、二階がアセンブリ製造職場、三階が設計開発

のオフィスで、設計と製造の距離をできるだけ近づけるという従来の方針を踏襲し、新たなスタートを切りました。



平成16年

3～4月 半導体製造装置、液晶・ハードディスクドライブ関連製造装置事業を譲受け

4月 子会社2社を合併(現(株)日立ハイテクトレーディング)

7月 子会社2社を合併(現(株)日立ハイテクマニファクチャ&サービス)



平成17年

4月 那珂事業所の新クリーンルーム棟が稼動
(株)日製サイエンスを吸収合併

4～9月 海外拠点の統合および設立

6月 CSR報告書発行

12月 栄研化学(株)と業務・資本提携契約締結



平成17年4～9月 海外拠点の統合および設立

販売とサービスの運営体制構築によるCS(顧客満足度)向上、地域統括機能強化、経営効率向上などによる企業グループ価値最大化を図るため、海外グループ会社の再編を行いました。8社のサービス事業を合併、事業譲渡および業務委託により再編成しています。また、この年の4月にはソウル支店を、9月には台北支店を現地法人化とともに、5月には中国に新会社を設立しました。新体制で企業価値の向上に努めてまいります。



平成17年6月 CSR報告書発行

「環境報告書」から「CSR報告書」へ

当社は平成14年から環境報告書を発行していましたが、当社のCSR(企業の社会的責任)活動を広く社内外のステークホルダーの皆様にご理解いただくことを目的として、従来の環境報告書に、マネジメント体制の説明・社会性報告・経済性報告などのCSRの要素を加えて内容を拡充・発展させた、「CSR報告書」を作成しました。



2006

平成18年

4月 日立ハイテク電子エンジニアリング(株)を吸収合併

平成18年度中間期 事業概況

電子デバイスシステム

■主な製品

エッティング装置・スキャン露光装置などの半導体製造装置、測長SEM・外観検査装置などの半導体製造工程検査装置、電子顕微鏡、液晶関連製造装置、ハードディスクドライブ関連製造装置、社会システム関連装置



デジタルエクトレビューセンターハウス
SEM

半導体製造装置については、主力製品の測長SEMはアジア市場向けが伸張し、前年同期比で増加となりました。また、エッティング装置も米国市場向けが伸長しました。後工程装置も台湾市場向けが好調に推移しました。

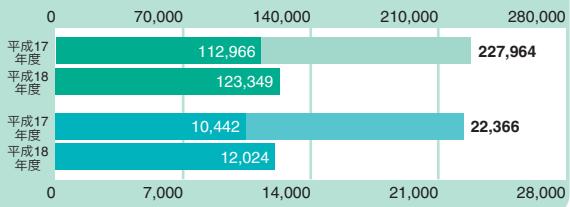
液晶関連製造装置は、国内メーカーで旺盛な設備投資が行われましたが、海外新興装置メーカーとの競合激化により前年同期比で微増に留まりました。

ハードディスクドライブ関連製造装置については、パソコン市場に加え、情報家電など非パソコン市場用途が増えたことによる、日系メーカーの国内外での旺盛な投資に支えられ、引き続き大幅に増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は123,349百万円(前年同期比9.2%増)、営業利益12,024百万円(前年同期比15.2%増)となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)



■(上期) ■(下期) 連結売上高
■(上期) ■(下期) 連結営業利益

ライフサイエンス

■主な製品

バイオ関連機器、医用分析装置、質量分析計・核磁気共鳴装置・分光光度計・クロマトグラフ・遠心機などの各種分析計測機器



タンパク質解析専用分析装置

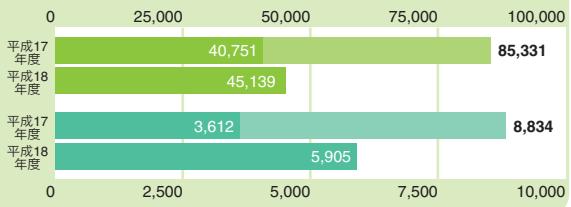
医用分析装置は、欧米における免疫分析システムに対する需要が引き続き好調に推移し、また新製品の投入も寄与して前年同期比で増加となりました。

遺伝子解析装置は、ポストヒトゲノム解析の需要増があったものの、ゲノム解析の需要が一巡し縮小しました。一方、汎用分析装置は好調に推移し、バイオ関連機器全体では前年同期比で横ばいとなりました。

以上の結果、当セグメントの売上高は45,139百万円(前年同期比10.8%増)、営業利益5,905百万円(前年同期比63.5%増)となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)



■(上期) ■(下期) 連結売上高
■(上期) ■(下期) 連結営業利益

情報エレクトロニクス

■主な製品

電子部品実装システム、有機EL製造装置、自動組立システム、自動車用各種計測・検査機器、発・変電設備、研究試験設備、コンピュータシステム、プリンタ・磁気記憶装置などの周辺機器、半導体・集積回路、電子デバイス、液晶表示装置、ブロードバンド、民生用情報機器、その他各種電子部品



ダイレクトドライブ
モジュラーマウンタ

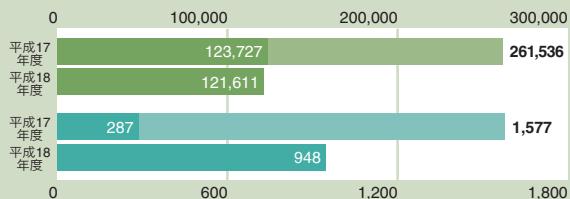
携帯電話用半導体は、欧州・アジア市場向けが不振で前年同期比で大幅な減少となりました。情報通信関連では、ブロードバンド関連製品が欧州市場向けに大きく伸長するとともに、米国市場向け携帯電話取引が立ち上がり、前年同期比で大幅に増加しました。

チップマウンタは、国内・中国市場においてデジタル家電向けが伸長しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は121,611百万円(前年同期比1.7%減)、営業利益948百万円(前年同期比230.8%増)となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)



■(上期) ■(下期) 連結売上高
■(上期) ■(下期) 連結営業利益

先端産業部材

■主な製品

鉄鋼製品、非鉄金属製品、基板材料、合成樹脂、電子材料、光通信部材、光ストレージ部材、その他化成品、建設資材、自動車関連機器、石油・石油製品・ガス



光メディア部材

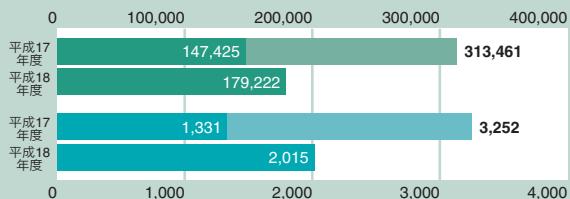
素材の高騰が継続しており建設機器関連向け非鉄金属などが堅調に推移するとともに、自動車関連部品も好調に実績をあげました。

シリコンウェーハは、需要の増加により順調に推移しました。一方で光学部品などは、最終製品の価格競争が激化し、苦しい価格政策を余儀なくされたため、伸び悩みました。

以上の結果、当セグメントの売上高は179,222百万円(前年同期比21.6%増)、営業利益2,015百万円(前年同期比51.3%増)となりました。

連結売上高・連結営業利益の推移

(百万円)



■(上期) ■(下期) 連結売上高
■(上期) ■(下期) 連結営業利益

トピックス

内部統制システムを取締役会議決議

当社は会社法に定める「委員会設置会社」として、監督機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図っています。また、法令および定款への適合性確保などのため、内部統制システムの整備についても積極的に取り組んでおり、本年4月24日開催の当社取締役会において決議しました。

エマージング市場への拠点配置



製造・販売・サービスの一貫体制の構築については、グローバル規模での展開に本腰を入れています。今後の施策として、まず、ベトナム、インド、ロシアといった地域において、新たに事業拠点を設置するなど、新市場での開拓を進めます。また、海外の重点顧客との間で製品の共同開発を進めることにより、「重点顧客密着型ビジネス」を推進します。さらに、海外販売会社とサービス会社の統合を進めることで、一貫性を強化してまいります。

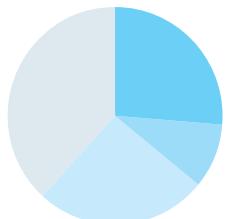
本社・支店の全部門でISO9001の認証を取得

品質マネジメントシステムの国際標準規格ISO9001の認証登録範囲を本社、支店の全部門(21ヶ所)に拡大し、平成18年7月21日に認証を取得了。

商社として全国の営業部門がISO9001の認証を取得したことは、先進的事例として注目されます。

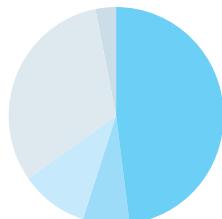
当社は、品質マネジメントシステムを会社経営の中核システムと位置付けており、今回の拡大認証を新たなスタートラインとして、従業員一人ひとりのさらなる意識向上とともに、品質マネジメントシステムの継続的な改善・維持管理を行い、全社を挙げて「顧客満足度の向上」を実現してまいります。

セグメント別売上高



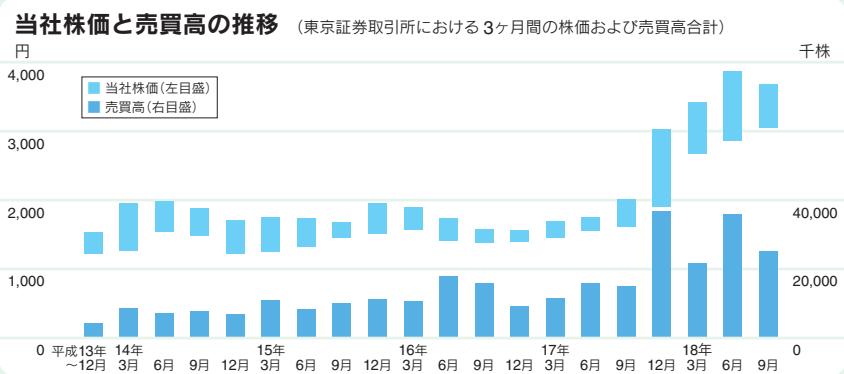
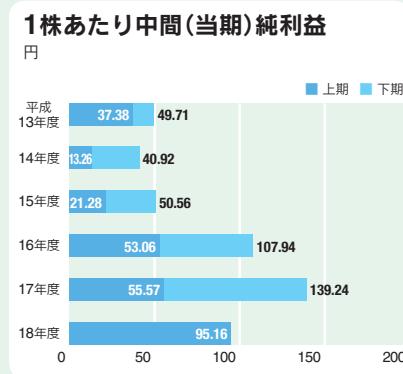
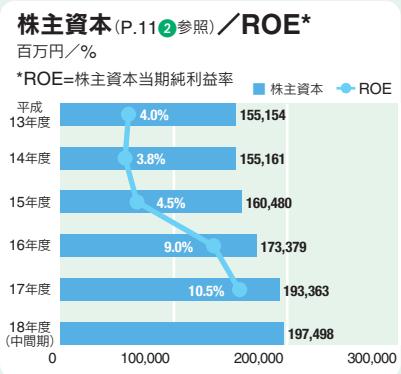
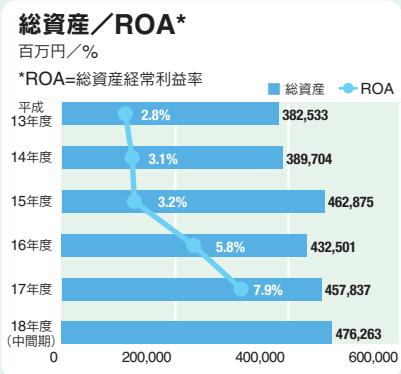
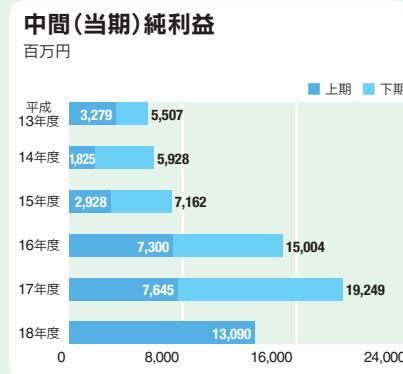
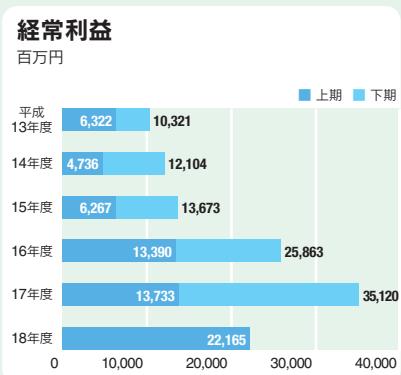
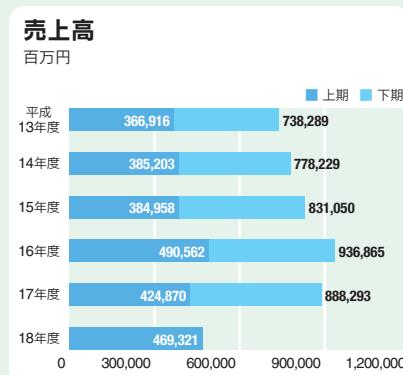
● 電子デバイスシステム 26.3%
● ライフサイエンス 9.6%
● 情報エレクトロニクス 25.9%
● 先端産業部材 38.2%
(平成18年度中間期)

海外売上高



● 日本 48.0%
● 北米 7.0%
● 欧州 10.2%
● アジア 31.7%
● その他の地域 3.1%
(平成18年度中間期)

財務ハイライト(連結)



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当中間期末 (平成18年9月30日現在)	前中間期末 (平成17年9月30日現在)	前事業年度末 (平成18年3月31日現在)
資産の部			
流動資産	380,430	326,425	360,955
現金及び預金	30,128	32,137	31,174
受取手形及び売掛金	235,012	204,194	238,183
有価証券	144	113	128
たな卸資産	67,194	52,127	59,082
繰延税金資産	16,658	16,721	16,325
前渡金	2,622	1,739	2,112
① 関係会社預け金	24,033	19,094	12,501
その他	7,053	4,317	4,682
貸倒引当金	△ 2,414	△4,017	△ 3,233
固定資産	95,833	93,046	96,882
有形固定資産	54,103	55,594	54,584
建物及び構築物	20,613	21,082	21,076
機械装置及び運搬具	7,110	7,197	7,359
工具器具備品	6,341	6,859	6,024
土地	19,902	20,054	20,087
建設仮勘定	137	401	39
無形固定資産	3,915	8,348	4,346
営業権	—	183	10
のれん	238	—	—
ソフトウェア	3,371	4,126	3,642
施設利用権	108	116	111
連結調整勘定	—	3,680	364
その他	198	243	219
投資その他の資産	37,816	29,104	37,952
投資有価証券	21,467	17,524	22,294
長期貸付金	684	1,017	729
繰延税金資産	6,616	4,931	6,122
その他	9,910	6,614	9,708
貸倒引当金	△ 861	△982	△ 901
資産合計	476,263	419,471	457,837

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

科 目	当中間期末 (平成18年9月30日現在)	前中間期末 (平成17年9月30日現在)	前事業年度末 (平成18年3月31日現在)
負債の部			
流動負債	239,510	205,097	231,453
支払手形及び買掛金	182,383	153,564	182,047
短期借入金	—	3,658	—
一年以内に返済予定の長期借入金	—	1,000	—
未払法人税等	9,944	4,948	5,948
未払費用	29,937	26,748	27,246
前受金	7,137	5,062	6,059
その他	10,109	10,117	10,153
固定負債	28,462	28,966	28,368
退職給付引当金	27,201	27,700	27,011
役員退職慰労引当金	974	935	991
その他	287	332	365
負債合計	267,973	234,063	259,821
純資産の部			
株主資本	197,498	—	—
資本金	7,938	—	—
資本剰余金	35,745	—	—
利益剰余金	154,099	—	—
自己株式	△ 284	—	—
評価・換算差額等	6,081	—	—
その他有価証券評価差額金	6,346	—	—
繰延ヘッジ損益	△ 205	—	—
為替換算調整勘定	△ 60	—	—
少数株主持分	4,711	—	—
純資産合計	208,291	—	—
負債及び純資産合計	476,263	—	—
少数株主持分			
少数株主持分	—	4,135	4,653
資本の部			
資本金	—	7,938	7,938
資本剰余金	—	35,745	35,745
利益剰余金	—	132,931	143,160
その他有価証券評価差額金	—	6,099	7,109
為替換算調整勘定	—	△1,186	△ 319
自己株式	—	△254	△ 270
資本合計	—	181,273	193,363
負債、少数株主持分及び資本合計	—	419,471	457,837

連結損益計算書

科 目	(単位:百万円)		
	当中間期 (平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで)	前中間期 (平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで)	前事業年度 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
	売上高	469,321	424,870
③ 売上原価	400,732	362,327	757,286
売上総利益	68,589	62,543	131,007
販売費及び一般管理費	47,716	46,855	94,971
営業利益	20,873	15,688	36,036
営業外収益	2,647	1,161	3,381
営業外費用	1,355	3,116	4,297
経常利益	22,165	13,733	35,120
特別利益	527	—	—
特別損失	594	272	5,384
税金等調整前中間(当期)純利益	22,098	13,461	29,736
法人税、住民税及び事業税	8,994	4,306	10,014
法人税等調整額	△ 235	1,334	△ 63
少数株主利益	248	177	536
中間(当期)純利益	13,090	7,645	19,249

対前年度末比較増減

① 関係会社預け金

関係会社預け金が前事業年度末より115億円増加しました。

日立グループのキャッシュ・ポーリングへの預け金の増加によるものです。

② 純資産の部

貸借対照表の純資産の部の表示を定めた企業会計基準の適用により、従来の「少数株主持分」および「資本の部」が整理され、「純資産の部」として、株主資本と株主資本以外の各項目に区分表示しています。従来の「資本の部」の合計に相当する金額は203,784百万円です。

対前年同期比較増減

③ 営業外収益・営業外費用

営業外損益が前年同期より32億円増加しました。たな卸資産評価損の減少、貸倒引当金戻入益などの増加によるものです。

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	(単位:百万円)		
	当中間期 (平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで)	前中間期 (平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで)	前事業年度 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
	4 営業活動による キャッシュ・フロー	15,249	12,535
5 投資活動による キャッシュ・フロー	△ 2,791	△ 4,217	△ 9,578
6 財務活動による キャッシュ・フロー	△ 2,278	△ 6,713	△ 12,762
現金及び現金同等物に係る			
換算差額	306	423	1,111
現金及び			
現金同等物の増減額	10,486	2,028	△ 5,529
現金及び			
現金同等物の期首残高	43,600	48,967	48,967
新規連結に伴う現金及び			
現金同等物の増加額	—	162	162
現金及び現金同等物の			
中間期末(期末)残高	54,086	51,157	43,600

当中間期末におけるキャッシュ・フローの状況

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは152億円の増加となりました。主に、税金等調整前中間純利益で221億円、減価償却費35億円による増加と、法人税などの支払いによる支出50億円によるものです。

⑤ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは28億円の減少となりました。主に、有形・無形固定資産の取得による支出合計26億円によるものです。

⑥ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは23億円の減少となりました。主に、配当金の支払い21億円によるものです。

個別貸借対照表

				(単位:百万円)			
科 目	当中期末 (平成18年9月30日現在)	前中間期末 (平成17年9月30日現在)	前事業年度末 (平成18年3月31日現在)	科 目	当中期末 (平成18年9月30日現在)	前中間期末 (平成17年9月30日現在)	前事業年度末 (平成18年3月31日現在)
資産の部							
流動資産	295,291	236,347	266,328	流動負債	202,403	165,267	193,248
現金及び預金	9,319	10,693	7,062	支払手形	13,812	10,147	10,467
受取手形	10,647	9,512	10,247	買掛金	135,135	120,218	144,872
売掛金	182,543	151,443	185,028	未払金	3,392	2,378	3,061
有価証券	8	—	—	未払費用	17,331	11,897	12,780
たな卸資産	41,645	23,633	25,025	未払法人税等	6,495	2,297	2,839
短期貸付金	7,747	8,758	11,540	預り金	16,408	11,257	11,472
繰延税金資産	9,450	7,683	7,596	その他	9,830	7,073	7,757
① 関係会社預け金	24,033	19,094	12,501	固定負債	15,975	9,234	9,291
その他	11,892	7,781	9,656	退職給付引当金	15,220	8,760	8,716
貸倒引当金	△ 1,993	△ 2,250	△ 2,327	役員退職慰労引当金	561	474	557
固定資産	86,688	77,762	79,581	再評価に係る繰延税金負債	194	—	18
有形固定資産	46,204	39,071	37,656	負債合計	218,378	174,502	202,538
建物	14,491	11,987	11,676				
機械及び装置	5,280	5,118	5,179				
土地	21,389	16,558	16,559				
その他	5,044	5,407	4,241				
無形固定資産	3,548	4,624	3,873				
投資その他の資産	36,935	34,067	38,052				
投資有価証券	17,759	14,076	18,610				
関係会社株式	8,910	14,775	14,106				
繰延税金資産	2,044	27	—				
その他	9,059	6,117	6,182				
貸倒引当金	△ 836	△ 927	△ 845				
資産合計	381,979	314,109	345,908				
2 純資産の部							
株主資本	155,731	—	—	純資産合計	163,600	—	—
資本金	7,938	—	—	負債及び純資産合計	381,979	—	—
資本剰余金	35,745	—	—				
利益剰余金	112,332	—	—				
自己株式	△ 284	—	—				
評価・換算差額等	7,869	—	—				
その他有価証券評価差額金	6,230	—	—				
繰延ヘッジ損益	△ 204	—	—				
土地再評価差額金	1,843	—	—				
純資産合計	163,600	—	—				
資本の部							
資本金	—	7,938	7,938	資本合計	—	139,607	143,370
資本剰余金	—	35,745	35,745	負債・資本合計	—	314,109	345,908
利益剰余金	—	90,180	93,006				
その他有価証券評価差額金	—	5,998	6,951				
自己株式	—	△ 254	△ 270				

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

個別損益計算書

配当の状況

科 目	(単位:百万円)		
	当中間期 (平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで)	前中間期 (平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで)	前事業年度 (平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで)
	347,375	309,724	648,585
売上高	300,949	271,419	571,425
売上原価			
売上総利益	46,425	38,305	77,160
販売費及び一般管理費	31,293	29,480	59,007
営業利益	15,133	8,825	18,153
③ 営業外収益	3,075	2,147	3,043
営業外費用	381	1,664	2,247
経常利益	17,826	9,308	18,949
特別利益	10,084	—	—
特別損失	39	—	2,575
税引前中間(当期)純利益	27,870	9,308	16,374
法人税、住民税及び事業税	5,958	1,711	5,098
法人税等調整額	523	1,419	897
中間(当期)純利益	21,389	6,178	10,379
前期繰越利益	—	2,900	2,900
中間配当額	—	—	1,376
合併による未処分利益繰入額	—	223	223
中間(当期)未処分利益	—	9,301	12,126

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

対前年度未比較増減

① 関係会社預け金

関係会社預け金が前事業年度末より115億円増加しました。

日立グループのキャッシュ・ポーリングへの預け金の増加によるものです。

② 純資産の部

貸借対照表の純資産の部の表示を定めた企業会計基準の適用により、従来の「資本の部」が整理され、「純資産の部」として、株主資本と株主資本以外の各項目に区分表示しています。従来の「資本の部」の合計に相当する金額は163,804百万円です。

1株当たり配当金

(単位:円)

	中 間	期 末	年 間
平成18年度 (当期)	12.50	12.50 (予想)	25.00 (予想)
平成17年度 (前期)	10.00	15.00	25.00

(注) 1. 平成18年度の期末配当金および年間配当金額は、平成18年10月24日時点における予想です。

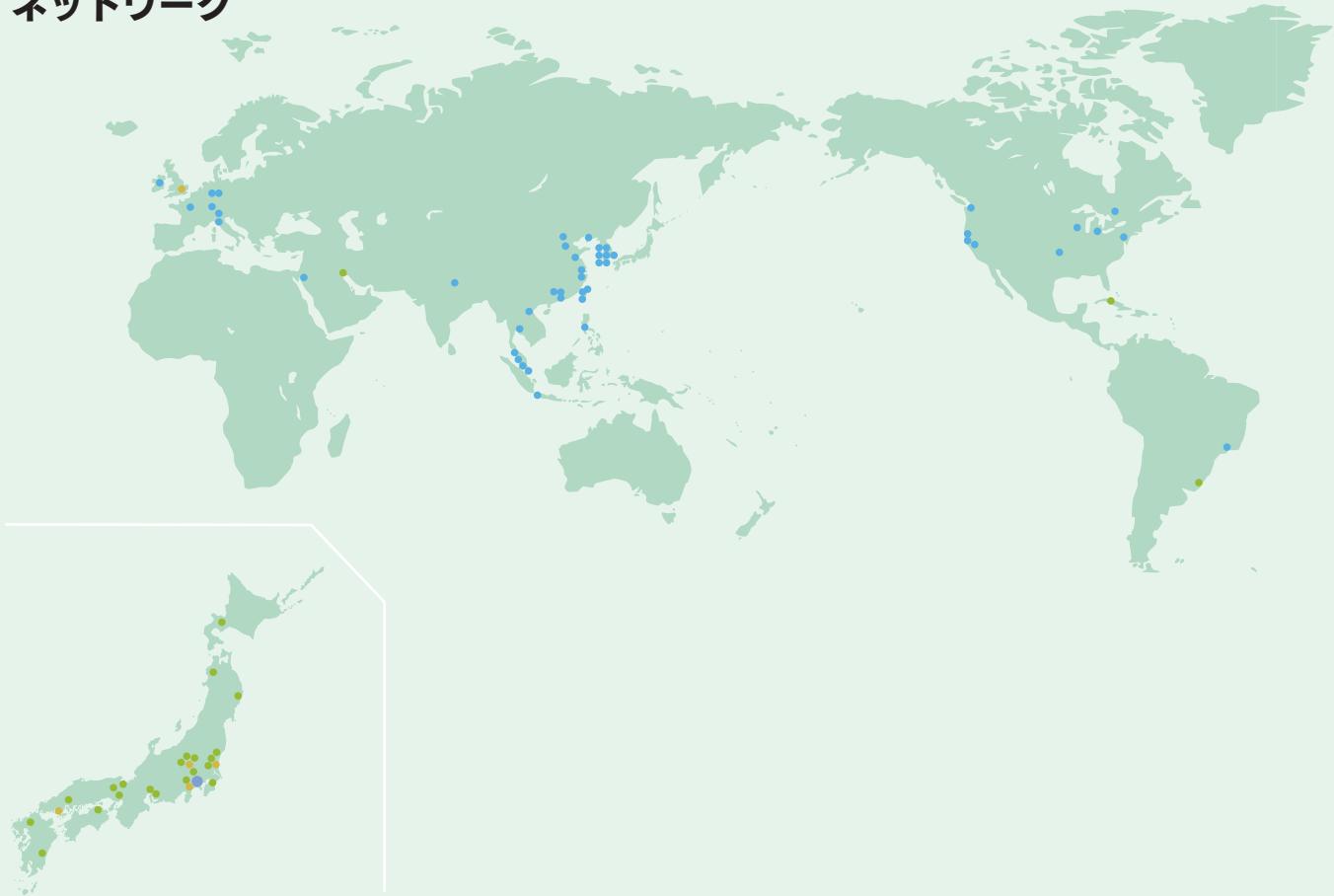
2. 平成17年度の期末配当金額は、記念配当5円を含んでいます。

③ 営業外収益・営業外費用

営業外損益が前年同期より22億円増加しました。

受取り配当金の増加、たな卸資産評価損の減少などによるものです。

ネットワーク



国内事業所 (平成18年9月30日現在)

● 本社

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号

● 事業所

那珂事業所、笠戸事業所、湘南事業所、埼玉事業所

● 支社、支店、営業所

北海道支店、五所川原事務所、東北支店、高崎出張所、栃木営業所、宇都宮事務所、茨城支店、ひたちなか営業所、筑波支店、関東支社、日野営業所、茂原出張所、中部支店、豊田営業所、京都営業所、西日本支社、関西支店、中国支店、四国営業所、九州支店、南九州営業所

● 国内グループ会社

(販売6社、製造・サービス8社)

海外事業所 (平成18年9月30日現在)

● 支店

ロンドン支店

● 出張所

ハバナ出張所、ブエノスアイレス出張所、クウェート出張所

● 海外グループ会社

(米州地域3社、欧州地域4社、 ASEAN地域3社、その他アジア地域8社)

会社の概要(平成18年9月30日現在)

- 商 号 株式会社日立ハイテクノロジーズ
- 本店所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
- 設立年月日 昭和22年4月12日
- 資本金 7,938,480,525円
- 従業員 連結 10,187名
単独 3,909名

●役員

取締役会長	桑田 芳郎	執行役常務	中野 和助	執行役	飯塚 茂
代表執行役	林 将章	執行役常務	宮内 真澄	執行役	増山 正穂
兼 取締役	大林 秀仁	執行役常務	金内 寛	執行役	林 充宏
代表執行役 執行役専務	桜木 雅夫	執行役常務	三澤 寛	執行役	仙石 俊男
兼 取締役	山下 勝治	執行役常務	添田 信弘	執行役	森 民生
取締役	内田 晴康	執行役常務	川崎 義直	執行役	水野 克美
社外取締役	瀬口 龍一	執行役常務	水澤 浩	執行役	安藤 力
社外取締役	宗岡広太郎	執行役常務	和田 憲也	執行役	田地 新一
				執行役	大木 博
				執行役	中村 修



株式の状況(平成18年9月30日現在)

発行済株式総数

137,738,730株

株主数

7,155名

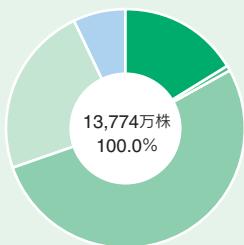
当年度株式移動状況

名義書換件数 205件

名義書換株式数 471,910株

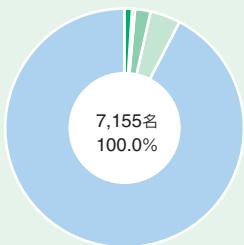
株式分布状況

所有者別株式分布状況(持株数)



- 金融機関 2,225万株 16.2%
- 証券会社 103万株 0.8%
- 国内事業法人 7,261万株 52.7%
- 外国人・外国法人 3,190万株 23.2%
- 個人・その他 994万株 7.1%

所有者別株式分布状況(株主数)



- 金融機関 68名 1.0%
- 証券会社 30名 0.4%
- 国内事業法人 152名 2.1%
- 外国人・外国法人 295名 4.1%
- 個人・その他 6,610名 92.4%

大株主

株主名	持株数	持株比率
(株)日立製作所	70,807,382株	51.4%
日本トラスト・サービス信託銀行(株)	6,889,100株	5.0%
日本マスタートラスト信託銀行(株)	5,490,600株	4.0%
資産管理サービス信託銀行(株)	4,197,400株	3.0%
ステートストリート バンク アンド トラスト カンパニー	3,875,353株	2.8%
インベスターーズ バンク アンド トラスト カンパニー	2,983,051株	2.2%
ジエーピーエムシービー	1,976,896株	1.4%
日立ハイテクノロジーズ社員持株会	1,680,836株	1.2%
メロンバンク エヌエー	1,494,883株	1.1%
ノーザン トラスト カンパニー	1,433,330株	1.0%

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
公告掲載新聞	日本経済新聞
剰余金の配当の受領株主確定日	毎年3月末日および9月末日
株主名簿管理人	東京証券代行株式会社
同上事務取扱場所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号 (東銀ビル3階)
電話	0120-49-7009 (03)3212-4611(代表)
上場証券取引所	東京・大阪証券取引所(市場第一部)

単元未満株式買取請求

単元未満株式の買取請求は、左記株主名簿管理人において受け付けております。

株券喪失登録

株券を紛失された方は、左記株主名簿管理人において株券喪失登録の手続きを行うことができます。株券喪失登録を行いますと、株券喪失登録簿に喪失株券の記号番号などが登録されて閲覧に供され、1年間喪失登録の抹消がなければ、当該株券は失効し、新しい株券の交付を受けることができます。株券喪失登録に要する費用は、1枚10,000円に加えて喪失登録株券1枚につき500円です。

東京証券代行株式会社各取次所についてのお知らせ

左記株主名簿管理人の取次所として中央三井信託銀行株式会社の本店および全国各支店において取次業務を行っております。

ご案内

当社ホームページ「株主・投資家向け情報」では、株主の皆様に最新情報をお届けしております。あわせてご覧ください。

<http://www.hitachi-hitech.com/ir/index.html>

click!



決算説明会の動画配信を始めました。



〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号
電話 (03)3504-7111
<http://www.hitachi-hitec.com>

お問い合わせ窓口
株式会社日立ハイテクノロジーズ
社長室 広報・IRグループ
電話 (03)3504-5138
E-mail: ir@nst.hitachi-hitec.com



古紙配合率100%再生紙を使用しています